

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-009

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	东北证券 华泰证券 中金公司 民生证券 悦溪基金 磐泽资产 申万菱信基金 浙商证券 为新资本（以上排名不分先后）
时间	2025年9月2日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 金卫勤 证券事务代表 施翌
主要内容介绍	<p>公司证券事务代表向与会人员介绍了公司概况、发展布局、公司重大事项，董事会秘书同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下：</p> <p>Q1、公司主营业务的部分的发展情况如何？</p> <p>公司主营业务产品目前仍以电磁屏蔽材料及绝缘材料为主。主要面对的市场为消费电子及新能源汽车汽车电子市场。上半年实现营收 1.543 亿，同比增长 18.98%，归母净利润 5456 万元，同比增长 81.78%。</p> <p>Q2、公司净利润同比增长的原因及毛利表现良好的原因是什么？</p> <p>公司主营业务所属的 3C 消费电子行业在结构性复苏与 AI 技术创新的驱动下，再叠加公司近年来不断对自身产品结构及客户结构</p>

	<p>进行优化调整，并逐步推进精细化管理策略，实现了今年公司业绩和利润的向上提升。</p> <p>Q3、公司并购的两个标的对公司未来的发展有什么影响？</p> <p>两个并购标的与本公司隶属同一行业，具有显著的协同效应。通过本次收购，首先将优化供应链管理，有效降低公司生产成本。其次，两个标的公司均具备深厚的技术积累和创新能力，其研发团队将显著增强公司自研体系的核心竞争力。最后，客户端的差异性可以促进各自的产品互通，客户互融，进一步拓展现有市场。通过本次收购可实现优势互补与资源协同，同时亦将保持业务端的独立运营体系，以并行发展模式释放协同价值，推动业绩提升。截至本记录表披露日，威斯双联已纳入本公司合并范围。德佑新材正在办理股权交割，目前尚未纳入公司合并报表范围。</p> <p>Q4、公司铜箔产品目前的进程和情况是什么样的？</p> <p>公司通过自有核心技术研发的 HVLP5 高频高速铜箔，具有极低的表面粗糙度且具备高剥离力的特点，未来可主要应用于 AI 服务器、通讯、车用雷达等需要高频高速低损耗的应用场景。公司已向中国（大陆及台湾地区）和日本的多家头部覆铜板厂商（CCL 厂）送样，目前公司与下游客户开发验证顺利推进中。目前，公司第一个 HVLP5 铜箔细胞工厂已完成建设，设备陆续装机中。但相关产品目前尚未形成规模化收入，郑重提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。</p> <p>Q5、公司铜箔对整个铜箔基板的影响是什么样的？</p> <p>理论上，基于集肤效应的原理铜箔的表面粗糙度越低，相应的对电流损耗就越少。但整个铜箔基板除铜箔之外仍需要结合玻纤布、树脂等其他材料，进行综合性能的测试。</p> <p>Q6、公司是否有供应 hvlp1-3 的铜箔？</p> <p>公司并没有制作及参与 hvlp1-3 等级铜箔的产品竞争。公司目前送样的产品为 hvlp5 等级的高频高速铜箔。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄

说明	露等情况。
日期	2025 年 9 月 2 日